

平成 22 年 12 月 14 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部
部長 本下 英治



TE7720PF 組立材料変更について

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社にてご採用頂いておりますTE7720PFにつきまして、下記内容の変更がございます。

下記の通りご報告させていただきますので、宜しくお願ひ申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

< 記 >

1. 対象型格：TE7720PF
2. 変更内容：ボンディングワイヤ・モールド樹脂材料の変更
【変更前】ボンディングワイヤ；Au材、モールド樹脂；エポキシType-B
【変更後】ボンディングワイヤ；Cu材、モールド樹脂；エポキシType-C
3. 変更理由：材料変更による安定供給、及び材料統一による生産性向上
型格、製品特性、信頼性、パッケージ寸法、実装保証条件に変更ございません。
4. 移管時期：2011年6月頃
弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。
詳細は、別途ご連絡させていただきます。
5. ラストオーダー：変更前の製品を購入希望の場合、2011年3月11日までにご発注頂きますよう、お願いいたします。
6. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。
7. 添付資料：1)信頼性試験データ、2)成分表をご参照頂けますようお願いいたします。
組立材料変更後の製品の信頼性評価結果に問題ございません。

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部

返却用

inrevium

TDGS26110

平成 22 年 12 月 14 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部
部長 本下 英治



TE7720PF 組立材料変更について

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社にてご採用頂いておりますTE7720PFにつきまして、下記内容の変更がございます。

下記の通りご報告させていただきますので、宜しく願い申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

< 記 >

1. 対象型格：TE7720PF
2. 変更内容：ボンディングワイヤ・モールド樹脂材料の変更
【変更前】ボンディングワイヤ；Au材、モールド樹脂；エポキシType-B
【変更後】ボンディングワイヤ；Cu材、モールド樹脂；エポキシType-C
3. 変更理由：材料変更による安定供給、及び材料統一による生産性向上
型格、製品特性、信頼性、パッケージ寸法、実装保証条件に変更ございません。
4. 移管時期：2011年6月頃
弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。
詳細は、別途ご連絡させていただきます。
5. ラストオーダー：変更前の製品を購入希望の場合、2011年3月11日までにご注文頂きますよう、お願いいたします。
6. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。
7. 添付資料：1)信頼性試験データ、2)成分表をご参照頂けますようお願いいたします。
組立材料変更後の製品の信頼性評価結果に問題ございません。

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED